

計劃名稱：產業新尖兵試辦計畫

學習獎勵金：

每月訓練總時數需達100小時以上，且訓練期間一個月以上始發給學習獎勵金(每月以30日計算)，超過30日之畸零數，依下列方式辦理：

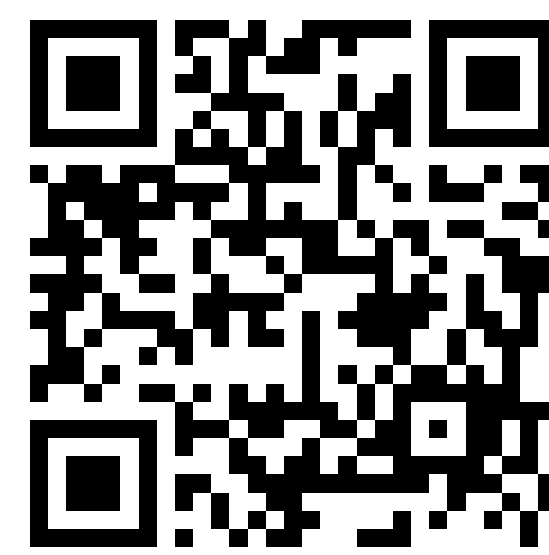
培練單位：南臺學校財團法人南臺科技大學

訓練班別：半導體製程與封裝人才培訓班

訓練日期：112年6月26日至112年8月11日

訓練費用：59,010元/每人(符合資格者由計畫全額補助)

訓練資格：本國籍15~29歲且大學畢業，未就業、未就學，或現就讀於大學夜間部者，須為理工相關科系



報名登記表

2021年我國半導體產業蓬勃發展，據工研院產科國際所統計，產值超過4兆元，業界求才孔急。因應半導體人才短缺，本課程將培訓學員具備光電半導體製作與分析之相關知識，並藉由實務操作來學習半導體製程設備、封裝設備與相關分析設備的基礎使用能力，提供產業界更多人力。

學員皆可從基礎學科「半導體特性基本概念」、「半導體製程簡介」、「真空技術」與「積體電路封裝」，習得半導體基礎知識，進而了解半導體產業並培養從事相關工程技術之技能。

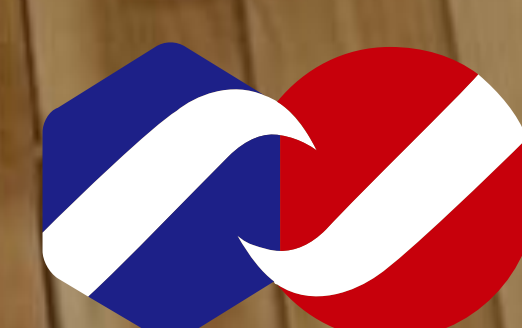
專業術科規劃重點在培養學員半導體產業實務能力，學習操作製程與分析等多項設備，使學員具實作能力，滿足業界對一線從業人員的基本要求，並能於將來順利就業。

**就業展望：**可從事製程工程師、設備工程師、封裝工程師、品保工程師、品質技術工程師等。

**報名聯絡方式：**(06)253-3131分機3601吳先生 E-mail：[youmingwu@stust.edu.tw](mailto:youmingwu@stust.edu.tw)

**擬開課內容210小時** 若疫情或防疫需要改為遠距教學，須準備網路及電腦相關設備(麥克風、鏡頭)

目次	課程名稱	課程類別	時數
1	半導體特性基本概念	學科	24
2	半導體製程簡介	學科	24
3	真空技術	學科	24
4	積體電路封裝	學科	18
5	通識課程	學科	6
6	半導體製程實習	術科	18
7	半導體製程與封裝實務	術科	71
8	半導體量測分析實務	術科	21
9	企業觀摩	術科	3
10	就業媒合活動	術科	1



南臺科技大學  
Southern Taiwan University of Science and Technology